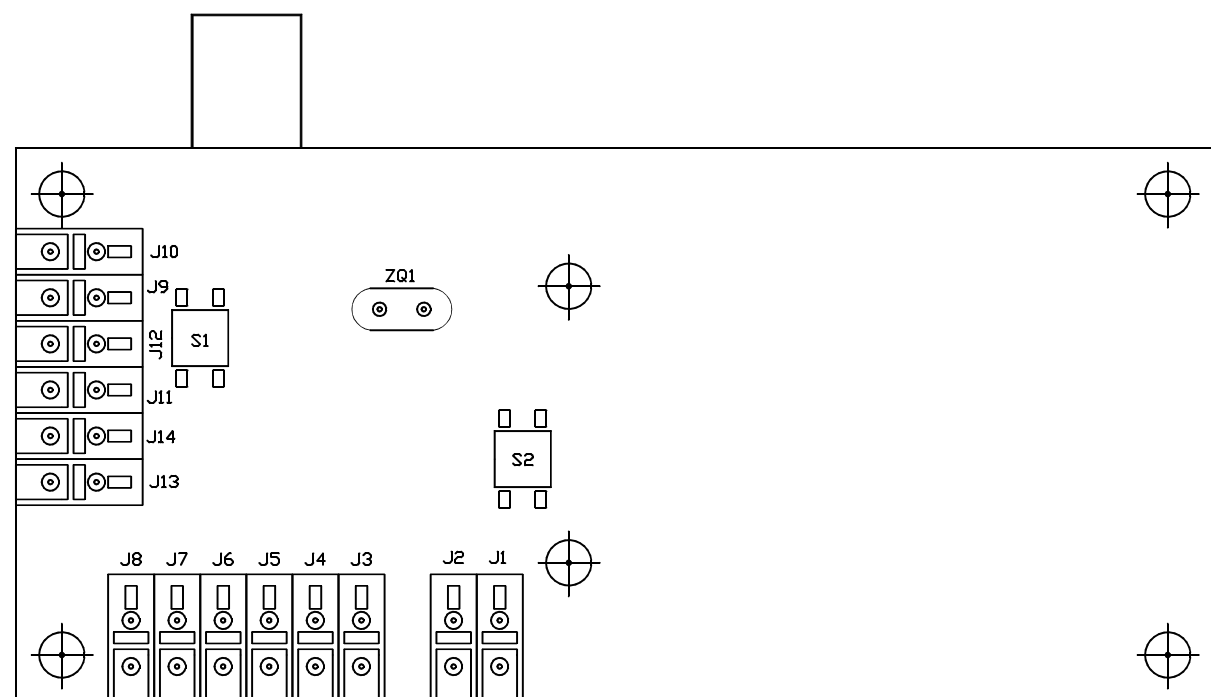
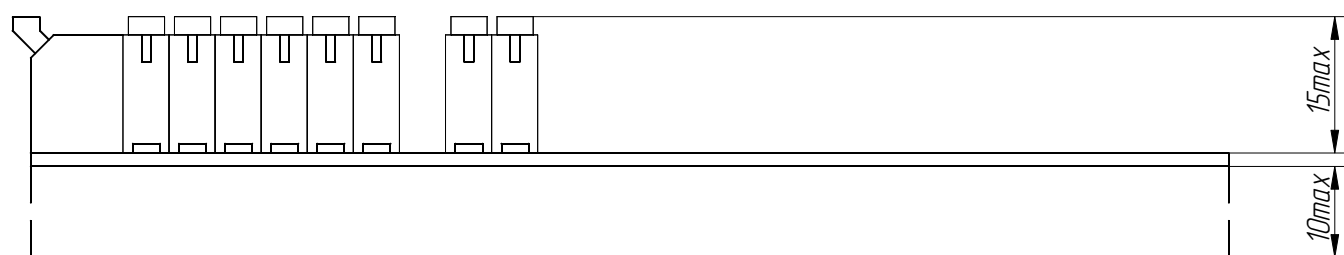
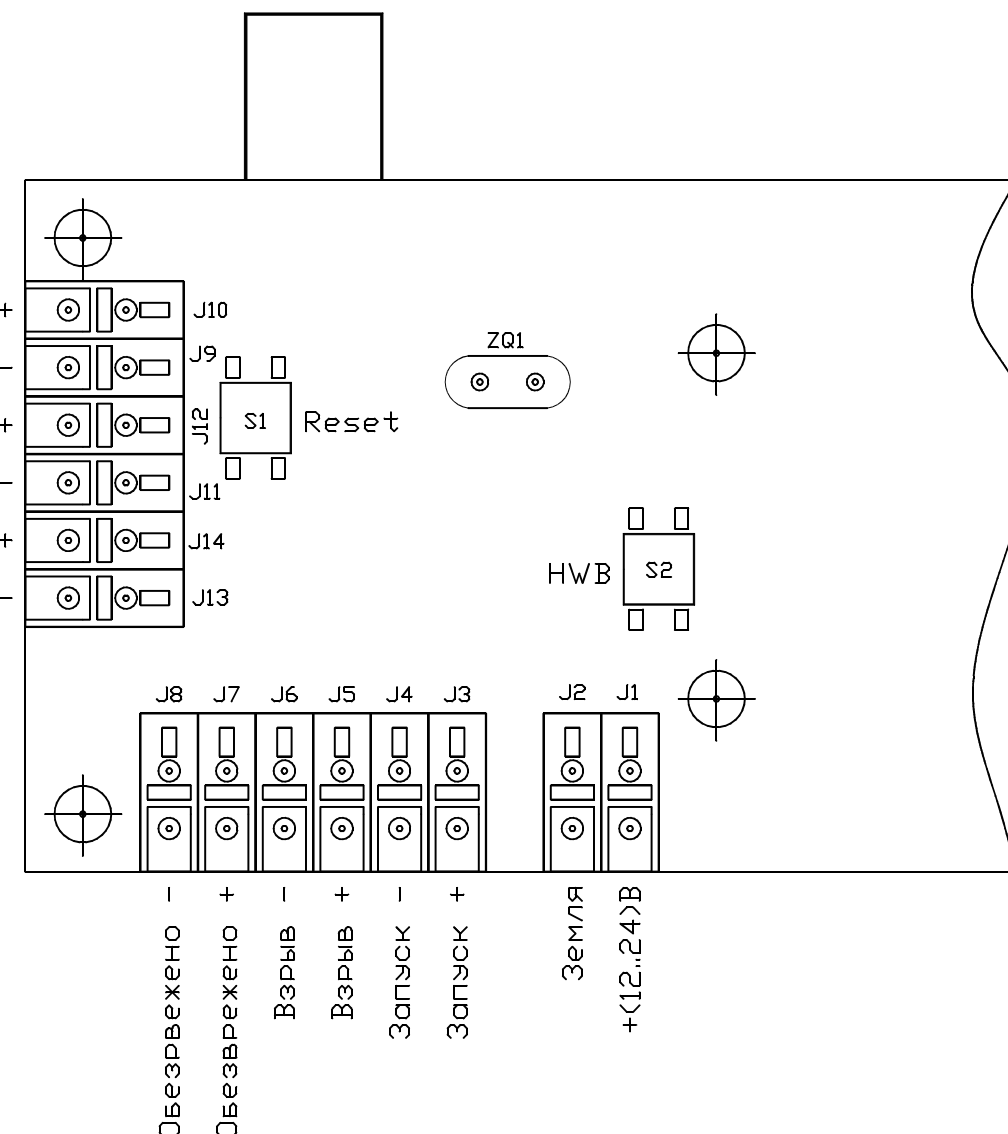


75,5max



Провод 1 +  
Провод 1 -  
Провод 2 +  
Провод 2 -  
Провод 3 +  
Провод 3 -



1. Размеры для справок
2. Покрытие платы HASL.
3. Паять припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76, элементы поверхностного монтажа пастой RM-89 или аналогом.
4. Элементы поз.49,57,59,63 устанавливать до упора в плату.
5. Элементы поз.31 устанавливать на прокладку выполненную из отрезка лены от чип-элементов.
6. На место поз.61 запаять шлейф IDC-20 (шаг 2,54мм) длиной 10см
7. Требования к пайке электроmontажных соединений по стандарту IPC-A-610E.
8. Остальные ТТ по ОСТ4.ГО.070.015

					BOOM-MCU_01v1 СБ							
0					Плата BOOM-MCU_01v1			Литера	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум	Подп.	Дата								1:1
Разраб.	Щедлыкин М.В.			16.09.15								
Пров.												
Т.контр.					Сборочный чертеж			Лист		Листов 1		
Н.контр.								ООО "Прософт-Системы"				
Утв.												